

## 南臺科技大學 106 學年度第 2 學期課程資訊

課程代碼	30D1CH01
課程中文名稱	電路板分析與拆錫實務
課程英文名稱	Principle of Circuit Board Analytics with Soldering and Unsoldering
學分數	2.0
必選修	管制選修
開課班級	四技電資四甲 四技控晶四甲四技控晶四乙四技網通四甲四技晶片四甲四技系統四甲四技微電四甲
任課教師	謝文哲
上課教室(時間)	週五第 5 節(J405) 週五第 6 節(J405) 週五第 7 節(J405) 週五第 8 節(J405)
課程時數	4
實習時數	2
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	
輔導考照 2	
課程概述	培養學生電路板分析與拆錫相關技術及知識，為業界實用之技能。
先修科目或預備能力	
課程學習目標與核心能力之對應	<p>※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標 -----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.了解電路板分析與拆焊相關技術。 ,-- ,1 專業技能</li> <li>2.能分析電路板故障原因，排除故障問題。 ,-- ,2 工程實務</li> <li>3.建立後續學習各種電路板分析與拆焊技巧之能力。  ,-- ,5 終身學習</li> <li>4.學習電路維修能力，避免失誤。  ,-- ,6 熱誠抗壓</li> <li>5.透過分組討論與實作，學習電路板分析與拆焊技巧。 ,-- ,8 專案管理</li> </ol>
中文課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.電路圖與電路板介面</li> <li>2.零件佈置</li> <li>3.電路板信號分析</li> </ol>

	<p>4.銀絲線佈局銲接</p> <p>5.銀絲線佈局銲接</p> <p>6.插件式元件基礎拆/銲接</p> <p>7.表面黏著元件基礎拆/銲接</p> <p>8.電子元件電路板實際操作</p> <p>9.成品電路板功能測試</p>
英/日文課程大綱	
課程進度表	<p>電路圖與電路板介面(第 1~2 週)</p> <p>零件佈置(第 3~4 週)</p> <p>電路板信號分析(第 5~6 週)</p> <p>銀絲線佈局銲接(第 7~8 週)</p> <p>銀絲線佈局銲接(第 9~11 週)</p> <p>插件式元件基礎拆/銲接(第 12~13 週)</p> <p>表面黏著元件基礎拆/銲接(第 14~15 週)</p> <p>電子元件電路板實際操作(第 16~17 週)</p> <p>成品電路板功能測試(第 18 週)</p>
教學方式與評量方法	<p>※課程學習目標，教學方式，評量方式</p> <p>-----</p> <p>了解電路板分析與拆焊相關技術。，課堂講授，實作</p> <p>能分析電路板故障原因，排除故障問題。，實作演練，實作</p> <p>建立後續學習各種電路板分析與拆焊技巧之能力。</p> <p>，實作演練，實作</p> <p>學習電路維修能力，避免失誤。</p> <p>，實作演練，實作</p> <p>透過分組討論與實作，學習電路板分析與拆焊技巧。，實作演練，實作</p>
指定用書	<p>書名：</p> <p>作者：</p> <p>書局：</p> <p>年份：</p> <p>ISBN：</p> <p>版本：</p>
參考書籍	放置於 Flip 數位學習網，請自行下載
教學軟體	
課程規範	

